# 円形空隙を用いた金属ミラー装荷アポダイズドグレーティングカプラの理論検討

# Apodized Grating Couplers with Circular Through-holes between Multilayer Waveguides with Metal Mirrors

°久能 雄輝<sup>1,\*</sup>,姜 畯炫<sup>1</sup>,林 侑介<sup>1</sup>,鈴木 純一<sup>1</sup>,雨宮 智宏<sup>2</sup>, 西山 伸彦<sup>1</sup>,荒井 滋久<sup>1,2</sup> °Yuki Kuno<sup>1</sup>, JoonHyun Kang<sup>1</sup>, Yusuke Hayashi<sup>1</sup>,Junichi Suzuki<sup>1</sup>, Tomohiro Amemiya<sup>2</sup>, Nobuhiko Nishiyama<sup>1</sup>, and Shigehisa Arai<sup>1,2</sup>

東京工業大学電気電子工学専攻1,量子ナノエレクトロニクス研究センター2

Dept. of Elect. and Electron. Engrg.<sup>1</sup>, Quantum Nanoelectron. Res. Center<sup>2</sup>, Tokyo Institute of Technology E-mail: \*kuno.y.ad@m.titech.ac.jp, http://www.pe.titech.ac.jp/AraiLab/

### 1. はじめに

アモルファスシリコン(a-Si:H)は 300°C以下の低温成膜 が可能であり、LSI上への光配線の導入に適した材料であ る。本研究グループでは a-Si:H を用いた多層光回路に用 いる層間光結合デバイスの研究を行い、グレーティングカプ ラの上下に金属ミラーを導入し効率的に結合する構造によ って、グレーティング間距離 1 µm において理論計算で 90%、実験的には 83%の結合効率を得た[1]。さらに、アポ ダイゼーションを行うことにより、2 µm 以上のグレーティング 間距離でも約 90%の結合効率が得られることを示した[2]。 今回は、グレーティング形状作製の簡易化を目的とし、円形 の空隙と溝を組み合わせたアポタイゼーション構造につい て検討したのでご報告する。

### 2. 実験

層間結合アポダイズドグレーティングカプラでは、グレー ティングの個々の溝幅の制御(アポダイゼーション)[3]により 送信側および受信側の放射モードプロファイルが一致する 設計とする。これによって送信側と受信側を多重反射する 光波成分が抑制され、グレーティング間距離に依存しない 結合特性が得られる。しかしこの場合、グレーティングの溝 幅は約 30 nm~300 nm となるため、細い部分の溝は露光 量およびエッチング深さの溝幅依存性から設計通りに作製 するのが困難である。そこで細い溝部分を穴を並べた構 造で代替する方法を検討した。

Fig. 1 に示す設計では溝幅が 150 nm 以下となる部分 を直径 200 nm の円形の穴の配列で置き換えている。穴の 深さは溝部分との同時エッチングを想定し、溝の深さと同じ 100 nm とした。この構造においては放射係数を穴の配列 の粗密により制御でき、放射モードプロファイルの調整が可 能であることが 3 次元 FDTD 法の解析により確かめられ た。

Fig. 2(b) には穴を用いた設計の結合特性を示す。穴を 用いない従来の設計(Fig. 2(a))と同様に、グレーティング 間距離に依存せず高効率で結合できることが示された。 Fig. 2(a)と比較して結合効率は低くなっているが、これにつ いてはアポダイゼーションの調整を含めて検討を行う必要 がある。

次にグレーティングカプラ部の試作を行った。PECVD 法 により 220 nm の厚さに成膜された a-Si:H を ICP-RIE に より約 100 nm エッチングした素子の上面 SEM 図を Fig.3 に示す。配列が密となる部分でも形の崩れはほとんどなく、 設計通り円形の穴が形成できることが確認された。





Fig. 3 SEM image of apodized grating coupler with circular through-holes.

**謝辞:**本研究は文部科学省科学研究費補助金(#24246061, #25709026, #13J08096)の援助により行われた。

#### 参考文献

- [1] J. Kang et al., Appl. Phys. Express **7** (2013) 032202.
- [2] 久能 他、電子情報通信学会 2014 年総合大会 (2014)C-3-12.
- [3] T. Tamir et al., Appl. Phys. 14 (1977) 235-254.